

2025年度 製造中核人材育成セミナー日程

	1日目 (火)	(プロセス)		2日目 (水)	(プロセス)		3日目 (木)	(プロセス)		4日目 (金)	(プロセス)
9:00			9			9	実習生プロセス ・ フォトリソ (3回目)		9	プロセス講義	
				プロセス講義	37. n-ch S/Dフォトリソ		周辺装置実習 ・ CMP装置説明	46.コンタクトフォトリソ		測定実習説明	52. 配線フォトリソ
			10			10	・ CMP実習 : A班→B班		10	実習生プロセス ・ フォトリソ (4回目)	53. Alエッチング
10:00				実習生プロセス ・ フォトリソ (2回目) ・ イオン注入	38. n-ch S/Dインプラ		・ CRユーティリティ見学 ・ EB露光装置見学 ・ B班→A班				54. フォトレジスト除去
	開始 10 : 30 御挨拶 (中村センター長)		11			11	休憩		11	実習生プロセス ・ エッチング (Metal-RIE) ・ レジスト除去 (WET) ・ Alシタリング	55. シタリング
	オリエンテーション	予備時間		休憩	39. フォトレジスト除去					CMOSプロセス実習 まとめ (CMSスタッフ)	
	安全教育			周辺装置実習 ・ マスクレス露光装置			館内・館外ユーティリティ見学	予備時間			
			12			12			12		
12:00	クリーンルーム入室・見学			昼食 Lunch	予備時間		昼食 Lunch			昼食 Lunch	予備時間
		予備時間	13		40. p-ch S/Dフォトリソ	13			13		
	昼食 Lunch			デバイス試作と回路設計	41. p-ch S/Dインプラ		プロセス講義	47. 酸化膜エッチング (RIE) 48. 酸化膜エッチング (Wet) 49. フォトレジスト除去	14	周辺装置実習 ・ ダイザー ・ ワイヤーボンディング	
13:00					42. フォトレジスト除去		実習生プロセス ・ エッチング (Si-RIE、BHF) ・ フォトレジスト除去 ・ スパッタリング			測定実習 ・ nMOS、pMOS静特性 ・ インバータ静特性 ・ リングオシレータ測定	実習データとりまとめ
	プロセス講義		14	プロセス講義	43. RCA洗浄	14			15		
14:00		34. ゲートフォトリソ		実習生プロセス ・ RCA洗浄 ・ 拡散炉			休憩	50. HF洗浄 51. Al堆積		まとめ (中村センター長) 修了証授与 終了16 : 00	
			15			15	周辺装置実習 FIB-SEM ・ FIB-SEMの紹介 ・ 既存CMOSチップの観察、FIB加工				
	実習生プロセス ・ フォトリソ (1 回目)			休憩	44. S/D活性化熱処理 45. 酸化膜堆積	16					
		35. Poly-Siエッチング	16	実習生プロセス ・ PE-CVD ・ 膜厚測定			プロセス講義	予備時間			
15:00		36. フォトレジスト除去		プロセス講義		17					
	休憩										
16:00	実習生プロセス ・ エッチング (Metal-RIE) ・ フォトレジスト除去 (PR)										
17:00	交流会 Q&A (自由参加)	予備時間	17	Q&A (自由参加)	予備時間	17	Q&A (自由参加)	予備時間			

座学など (AV講義室)

CMOSプロセス実習 (CR)

周辺装置実習・見学

昼食・休憩

注意 : セミナーの進捗状況によりスケジュールが変更になる場合がございます。